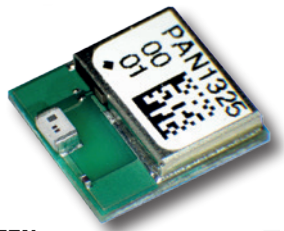


# BLUETOOTH 4.0 LE DUAL MODE HCI (SMART READY) MODUL PAN1326



## EIGENSCHAFTEN

- » Kommuniziert mit BT Low Energy Single-Mode-Geräten
- » Übertroffene Bluetooth RF Performance (Tx, Rx-Empfindlichkeit, Sperrung)
- » Vollständig qualifiziert für Bluetooth v4.0 EDR, FCC und IC gelistet, CE konform
- » Abmessungen 9,0 mm × 9,5 mm × 1,8 mm (B×L×H)
- » Betriebstemperaturbereich: -20°C bis + 70°C
- » Versorgungsspannungsbereich: 1,7 bis 4,8 V
- » Auf der Grundlage von TI CC2564
- » Profile: SPP, HDP, Audio und andere können auf dem Host-Prozessor ausgeführt werden (integriert: TI Ultra-Low-Power-MSP430 µP)
- » Sehr schneller Algorithmus für beide ACL und eSCO
- » Unterstützt erweiterte Sendeleistung mit 10,5 dBm typ.
- » Low Power Scan-Methode und Prüfungsscans bei 1/3 des normalen Stromes

## Schnittstellen

- » 3,25 MBaud UART mit Transportschichterkennung (HCI UART, HCI drei und vier Draht UART)
- » PCM / I<sup>2</sup>S für digitale Audio-Systeme

## ANWENDUNGEN

Sämtliche Wireless Anwendungen, z. B. medizinische Anwendungen, Drucker, Scanner, PDAs, access points, Sensoren, Industrieanwendungen, PC Motherboards & Peripheriegeräte, Mono- and Stereo Audio-Anwendungen

## SPEZIFIKATIONEN

PARAMETER	WERT	BEDING./ANMERK.
Receiver Empfindlichkeit (BER=10 <sup>-3</sup> )	-93 dBm	ideales Nutzsignal
Sendeleistung	10.5 dBm typ.	max. 4 dBm für BT Class 2
Stromversorgung	1.7 ... 4.8 V	Batterie oder DC/DC Konv.
Ultra Low Power Scan	135 µA	1.28s Interval
eSCO Link 2-EV3	8.3 mA	erweiterte Datenrate, 544.0 kb/s *1
EDR 3-DH1\3-DH5	39.2 mA	erweiterte Datenrate, 544.0 kb/s *1
Arbeitstemperaturbereich	-20°C ... +70°C	

\*1 Max. mögliche Datenrate bei diesem Pakettyp

**Panasonics neues PAN1326** Bluetooth Low Energy Dual-Mode-Modul ist ein applikationsgesteuertes Interface (HCI) und bringt Texas Instruments siebte Generation von Bluetooth-ICs, CC2564, in ein anwenderfreundliches Format. Mit der raumsparenden Technologie von Panasonic wurde ein Modul von nur 85.5mm<sup>2</sup> Größe produziert. Das Modul ist für die Leiterplatten-Pad-Pitch von 1,3mm und weniger als zwei Ebenen entwickelt worden. Es ist 100% Pin kompatibel mit der vorherigen Generation von klassischen Bluetooth-Geräten PAN1325.

Das einzigartige Design-Merkmal bietet die Möglichkeit, nahtlos von klassischen Bluetooth-Produkten zu Bluetooth-Produkten mit niedrigem Energieverbrauch zu wechseln.

Das Smart Ready Modul PAN1326 verbindet mobile Geräte wie Mobiltelefone und kleine Knopf-Batterie-Geräte wie Fitness-Sensoren, Uhren und Geräte im Gesundheitswesen. Es kann leicht eingefügt werden und schafft eine Datenkette von batteriebetriebenen Bluetooth- zu klassischen Bluetooth-Geräten.

## BLOCKDIAGRAMM

